バイアス印加スパッタ法による VO₂(B)及び VO₂(M)の選択成長 Selective growth of VO₂ (B) and VO₂ (M) by biased sputtering method 東海大院工 〇蘇 魁, ヌルー ハニス アズハン, 沖村 邦雄 Course of Electrical and Electronic System Engineering, Tokai Univ. [°]Kui Su, Nurul Hanis Azhan and Kunio Okimura sukui650639@hotmail.co.jp

二酸化バナジウム(VO₂)は 68℃程度で急峻な金属-絶縁体転移を示す VO₂(M)相の他に準安定相である VO₂(B)や VO₂(A)の存在が知られている. VO₂(B)の平板やロッド状のモフォロジーを利用してリチウムイオン電池や新型電 子デバイスへの応用が期待されている.^[1]しかし, VO₂ (B)の成長条件は明確なっていない. 特にデバイス応用上重 要となる純粋な VO₂(B)薄膜の堆積は困難である. VO₂(M)成長を指向した実験において VO₂(B)が混在することがあ る.本研究では,バイアス印加スパッタ法において VO₂(B)及び VO₂(M)の選択成長条件を調べた.

成膜はV金属(99.9%)をターゲットとする反応性スパッタ法において,基板バイアス機構を付加し,VO₂(B)の応用 を念頭に Mo フォイル(厚さ 0.02 mm)及びコーニングガラス基板上へ行った.成膜の基本条件は基板温度 250℃と 400℃,ターゲット RF 200 W,成膜時間を 40 min 一定とした.基板バイアスは、ヒーター上に V (99%)プレートを 置き、ブロキングコンデンサーを介する高周波電力(13.56 MHz)印加によって負の自己バイアスを発生させた.印加 電力を変えて成膜を行った.Fig.1(a), (b) に VO₆8 面体の連結が異なる VO₂ (B) 及び VO₂ (M) の結晶構造を示す.

Fig. 2(a) は Mo フォイル上に堆積した薄膜の XRD パターンとロッキングカーブである. 基板温度 250℃, 印加バ イアス0Wのとき, VO₂(B)の優先成長が得られた.印加バイアスを15Wとすると VO₂(M)相が配向的に成長し た.ロッキングカーブの半値幅 FWHM 3.0°が得られた. Fig. 2(b)は基板温度 400℃, 印加バイアス 0W のときコ ーニングガラス上に堆積した薄膜の XRD パターンとロッキングカーブである. この時 VO₂(B)の配向成長が得ら れ、ロッキングカーブの FWHM 6.0°が得られた. Fig. 3 にそれぞれの FE-SEM 像を示す. Fig. 3 (a) では VO₂ (B) に 特徴的なロット状の結晶粒の配列が見られる. Fig. 3 (b)では VO₂(M)相的な丸い結晶粒が見られる. Fig. 3 (c) では ランダムな VO₂ (B)のロット状のモフォロジーが見られる.[1] N. Ganganagappa and A. Siddaramanna, Materials Characterization 68 (2012)

